

2011-2012年全球及中国半导体设备行业研究报告

2011年半导体厂家资本支出（CAPEX）大约658亿美元，比2010年增加了14.3%，其中设备支出大约440亿美元，比2010年增加8.0%。预计2012年设备支出大约389亿美元，其中晶圆厂（Wafer Fab）设备313亿美元，比2011年均有所下滑。主要原因是2010年晶圆厂设备支出比2009年增长了127.1%，2011年又增长了13.3%，2012年出现下滑是正常的。

2012年资本支出超过50亿美元的仍然是英特尔、三星电子和台积电这三家。英特尔为建设全球第一座量产14nm 晶圆厂Fab 42 投资超过50亿美元，还有一座试验开发性质的14nm 晶圆厂D1X，英特尔继续引领半导体产业向20纳米以下发展，同时也再次确认英特尔在半导体制造领域无可撼动的霸主地位。

三星电子则计划支出134亿美元，是全球半导体领域资本支出最高的厂家，其中40%投入DRAM和NAND内存领域，其中包括引人瞩目的中国西安NAND工厂。三星大约50%投入System LSI领域，主要包括晶圆代工和AP业务。苹果的A5是其主要代工产品，预计A6 也会是三星代工。因为无论是A5 还是A6 ，与三星自己的AP都非常



近似，苹果担心委托其他晶圆代工有技术泄露的危险，而给三星则不用担心这个问题。为了获得苹果的认同，A5和A6将在美国本土的S1厂生产，三星将投资10亿美元大幅度扩展S1厂的产能。

台积电的28纳米工艺是全球仅次于英特尔的最先进的半导体生产工艺，客户愿意提前现金下单，订单已经排到2012年年底。台积电原本预计2012年资本支出60亿美元，不过近期台积电已经表明，可能提高资本支出到70亿美元以缓解产能紧张。

半导体设备领域是一个高度集中的领域，细分领域第一名的市场占有率往往超过50%，甚至90%，如CMP (chemical vapor deposition)领域，Applied Material的市场占有率为93%。PVD(physical vapor deposition or sputtering)领域，Applied Material的市场占有率为83%。即便是行业第二名都可能无法长久存活，这也促使设备行业并购不断。2010年11月，应用材料(Applied Materials)以49亿美元，正式完成收购Varian Semiconductor Equipment Associates。应用材料此举主要是加强离子植入ion implantation领域的竞争力。

2011年底，Lam Research以大约33亿美元的股票交易方式收购诺发系统公司(Novellus Systems)。Lam Research在蚀刻Etch市场占据55%的市场份额，Novellus则在ECD占有80%的市场份额。两家联合主要是为客户提供更完整的产品线。2011年4月，日本Advantest收购了新加坡Verigy，大大拓展了SoC测试领域。Teradyne则在2011年10月收购了LitePoint进入无线产品测试领域。



2008-2011年TOP 15半导体设备厂家收入排名（单位：百万美元）

排名	公司	2008	2009	2010	2011
1	ASML	4367	2268	5976	7551
2	Tokyo Electron	4343	2324	5827	5802
3	Applied Materials	4005	1960	5304	5415
4	KLA-Tencor	2112	1323	2893	2876
5	Lam Research	1904	1198	2952	2804
6	Dainippon Screen	1141	1105	2160	2105
7	Nikon	1742	787	1168	1646
8	Advantest	884	416	1135	1547
9	ASM International	961	690	1205	1443
10	Teradyne	925	552	1565	1429
11	Novellus Systems	970	582	1308	1319
12	Hitachi High-Technologies	1056	474	1093	1139
13	Varian	687	396	1088	1096
14	Hitachi Kokusai Electric	361	268	700	838
15	Kulicke & Soffa	328	225	763	830

来源：《2011-2012年全球及中国半导体设备行业研究报告》



报告目录

第一章、全球半导体产业

1.1、DRAM内存产业

1.1.1、DRAM内存产业现状

1.1.2、DRAM内存厂家市场占有率

1.1.3、移动DRAM内存厂家市场占有率

1.2、NAND闪存NAND Flash

1.3、IC制造与晶圆代工

1.4、IC封测产业概况

1.5、中国IC市场

1.6、中国晶圆代工产业

第二章、半导体设备产业

2.1、半导体设备市场

2.2、刻蚀设备产业

2.3、薄膜沉积设备产业

2.4、光刻机设备产业

2.5、半导体进程控制设备

2.6、复合半导体设备市场

2.6.1、Aixtron

2.6.2、VEECO

2.7、线邦定设备市场

2.8、半导体设备厂家排名

第三章、主要半导体设备厂家研究

3.1、Applied Materials

3.2、ASML

3.3、Tokyo Electron

3.4、KLA-Tencor

3.5、Lam Research

3.6、DAINIPPON SCREEN

3.7、尼康精机

3.8、Advantest

3.9、Hitachi High-Technologies

3.10、ASM International N.V.



3.11、Teradyne

3.12、日立国际电气

3.13、Kulicke & Soffa

第四章、主要半导体厂家研究

4.1、台积电

4.2、三星

4.3、英特尔



图表目录

- 2000-2012年DRAM产业CAPEX
- 2000-2013年全球DRAM出货量
- 2009年10月-2012年1月DRAM合约价涨跌幅
- 2005年1季度-2012年4季度全球DRAM厂家收入
- 2010年1季度-2012年4季度全球DRAM晶圆出货量
- 2001-2013年 系统内存需求量
- 2011年3-4季度全球DRAM内存品牌厂家收入和市场占有率排名
- 2009-2011年Mobile DRAM 主要厂家市场占有率
- 2011年NAND Flash制造商收入排名和市场份额
- 2011年全球12英寸晶圆产能
- 2011年全球前25大半导体厂家销售额排名
- 1999-2012年全球12英寸晶圆厂产能地域分布
- 2005-2011年全球晶圆代工厂销售额排名
- 2011年全球前20大MEMS晶圆代工厂排名
- 2011年全球OSAT厂家市场占有率
- 2007-2011年台湾封测产业收入



- 2010-2013年全球半导体封装材料厂家收入
- 2007-2011年中国IC市场规模
- 2011年中国IC市场产品分布
- 2011年中国IC市场下游应用分布
- 2011年中国IC市场主要厂家市场占有率
- 2011年中国晶圆代工厂家销售额
- 2005-2012年SMIC收入与运营利润率
- 2009年1季度-2011年4季度SMIC收入与毛利率
- 2009年1季度-2011年4季度SMIC收入下游应用分布
- 2009年1季度-2011年4季度SMIC收入地域分布
- 2009年1季度-2011年4季度SMIC每季度收入节点 (Node) 分布
- 2009年1季度-2011年4季度SMIC出货量与产能利用率
- 2010年1季度-2011年4季度SMIC各工厂产能
- SMIC工厂分布
- SMIC主要客户
- 2007-2016全球晶圆设备投入规模
- 2011-2016年全球半导体厂家资本支出规模
- 2011-2016年全球WLP封装设备开支



- 2011-2016年全球Die封装设备开支
- 2011-2016年全球自动检测设备开支
- 2011-2012年全球TOP 10 半导体厂家资本支出额
- 2011年4季度-2012年4季度主要Fab支出产品分布
- 2010年1季度-2013年4季度全球晶圆加载产能产品分布
- 2010-2012年全球晶圆设备开支地域分布
- 2010-2013年全球半导体材料市场地域分布
- 2010-2012年全球半导体后段设备支出地域分布
- 2000\2005\2010刻蚀设备市场主要厂家市场占有率
- 2000\2005\2010年全球CVD、PVD、ECD、CMP主要厂家市场占有率
- 1992-2011年全球光刻机厂家市场占有率
- 1995-2012年半导体进程控制设备市场增幅
- 1999-2010年MOCVD市场主要厂家市场占有率
- 1998年1季度-2011年4季度全球MOCVD新订单
- 2009-2013年MOCVD市场规模
- AIXTRON全球分布
- 2003-2011年AIXTRON收入与EBIT
- 1999-2011年AIXTRON收入下游应用分布



- 2010年1季度-2011年4季度AIXTRON新订单
- 2010年1季度-2011年4季度AIXTRON在手订单
- 2011年AIXTRON收入地域分布
- 2004-2012年VEECO收入与运营利润率
- 2010-2011年VEECO MOCVD下游应用
- 2008-2010年全球线邦定市场规模与主要厂家市场占有率
- 2010年1季度-2011年3季度全球自动线邦定主要厂家市场占有率
- 2011-2016年全球Ball Bonder市场铜线比例
- 2004-2015年OSAT厂家收入
- 2005-2016年全球封装节点分布
- 2006-2011年TOP 15全球半导体设备厂家收入排名
- 2007-2011年AMAT销售额与毛利率、运营利润率
- 2007-2011年AMAT新订单额与在手订单额
- 2010年1季度-2011年4季度AMAT新订单额与运营利润
- 2010年1季度-2011年4季度AMAT销售额与运营利润率
- 2009-2011年AMAT新订单地域与分布
- 2009-2011年AMAT新订单部门分布
- 2010-2011年AMAT在手订单部门分布



- 2009-2011年AMAT销售额地域分布
- 2009-2011年AMAT销售额部门分布
- 2009-2011年AMAT半导体设备部门新订单业务分布
- 2007-2011年ASML销售额与毛利率
- 2006年1季度-2011年4季度ASML销售额
- 2010年1季度-2011年4季度每季度ASML销售额与运营利润率
- 2010年1季度-2011年4季度每季度ASML销量与ASP
- 2010年1季度-2011年4季度每季度ASML销售额与在手订单
- 2010-2011年ASML在手订单额地域分布
- 2010-2011年ASML在手订单额下游应用分布
- 2010-2011年ASML在手订单额技术分布
- ASML路线图
- 2005-2012财年TEL销售额与运营利润率
- TEL全球分布
- 2006-2012财年TEL半导体设备销售额
- 2006-2011财年TEL 销售额地域分布
- 2010年1季度-2011年4季度TEL新订单
- 2005年4季度-2011年4季度TEL半导体设备下游应用分布



- 2011财年3季度-2012财年3季度TEL半导体设备收入与运营利润率
- 2011财年3季度-2012财年3季度TEL半导体设备收入地域分布
- 2007-2012财年KLA-Tencor收入与运营利润率
- 2009-2012财年上半年KLA-Tencor收入业务分布
- 2010-2011年KLA-Tencor收入下游应用分布
- 2009-2012财年上半年KLA-Tencor收入地域分布
- 2007-2012年Lam Research收入与运营利润率
- 2007-2011年Novellus收入与净利润
- 2010年1季度-2011年4季度Novellus销售额与毛利
- 2010年1季度-2011年4季度Novellus Net Order与环比增幅
- 2009-2011年Novellus收入地域分布
- 2011年4季度Lam Research收入下游应用分布
- 2009-2012财年上半年Lam Research收入地域分布
- 2009-2011年Lam Research在手订单Backlog
- DAINIPPON SCREEN MFG组织结构
- 2007-2012财年DAINIPPON SCREEN收入与运营利润率
- 2009财年4季度-2012财年3季度DAINIPPON SCREEN每季度各部门收入与运营利润率
- 2009财年4季度-2012财年3季度DAINIPPON SCREEN每季度各部门新订单与在手订单



- 2009财年4季度-2012财年3季度DAINIPPON SCREEN半导体设备部门下游应用分布
- 2007-2012财年DAINIPPON SCREEN半导体设备销售额
- 2010年2季度-2011年4季度DAINIPPON SCREEN半导体设备销售额与运营利润率
- 2011-2012财年DAINIPPON SCREEN半导体设备销售额地域分布
- 2006-2012年尼康精机销售额与运营利润率
- 2009-2012年尼康精机Stepper出货量类型分布
- 2011财年1季度-2012财年3季度Advantest毛利率与运营利润
- 2011财年1季度-2012财年3季度Advantest新订单部门分布
- 2011财年1季度-2012财年3季度Advantest新订单地域分布
- 2011财年1季度-2012财年3季度Advantest销售额部门分布
- 2011财年1季度-2012财年3季度Advantest销售额地域分布
- 2000-2011年Advantest半导体测试部门销售额下游应用分布
- Advantest全球分布
- 2007-2012财年Hitachi High-Technologies收入与运营利润率
- 2011-2012财年Hitachi High-Technologies收入部门分布
- 2011-2012财年Hitachi High-Technologies运营利润部门分布
- 2006-2011年ASM销售额与运营利润率
- 2006-2011年ASM销售额业务分布



- 2011年ASM Front-end业务销售额地域分布
- 2011年ASM Back-end业务销售额地域分布
- 2010年1季度-2011年4季度 Teradyne收入与运营利润率
- 2005年1季度-2011年4季度Teradyne SOC产品新订单
- 2011年4季度 Teradyne销售额与在手订单地域分布
- 2007-2012年日立国际电气收入与运营利润率
- 2008-2012财年Hitachi Kokusai Electric收入业务分布
- 2008-2011财年Hitachi Kokusai Electric营业利润业务分布
- 2007-2011年Kulicke & Soffa收入与运营利润率
- 2009-2011财年Kulicke & Soffa前10大客户
- Kulicke & Soffa全球分布
- 2010年1季度-2011年4季度Kulicke & Soffa收入与运营利润率
- TSMC组织结构
- 2004-2011年TSMC收入与营业利润率
- 2004-2011年TSMC出货量与产能利用率
- 2009年1季度-2011年4季度TSMC每季度收入与营业利润率
- 2009年1季度-2011年4季度TSMC每季度出货量与营业利润率
- 2005年-2011年4季度TSMC产品下游应用分布



- 2008年3季度-2011年4季度台积电收入节点分布(By Node)
- 2008-2011年台积电各工厂产能
- 2011年1季度-2012年4季度三星System LSI 事业部收入业务分布
- 2011年1季度-2012年4季度三星System LSI 事业部收入与运营利润率
- 2011年1季度-2012年4季度三星NAND内存收入与运营利润率
- 2011年1季度-2012年4季度三星DRAM内存收入与运营利润率
- 2004-2011年英特尔收入与毛利率
- 2004-2011年英特尔收入与运营利润率
- 2004-2011年英特尔收入与净利率
- 2006-2011年Q4 英特尔收入地域分布
- 2006-2008年英特尔收入产品分布
- 2008-2010年英特尔收入产品分布
- 英特尔CPU工艺路线图
- Intel全球基地分布
- INTEL WAFER FAB LIST



购买报告

价 格	电子版：8500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：9000元	传真：010-8260.1570
页数：121页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-04		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201204/24511452.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		



如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

